



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203407061 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201320420434. 8

(22) 申请日 2013. 07. 16

(73) 专利权人 常州紫寅电子电路有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进区高新技术
产业开发区南区凤栖路 10 号

(72) 发明人 顾国文 邵春华 侯立梁

(74) 专利代理机构 常州市夏成专利事务所（普
通合伙） 32233

代理人 沈兵

(51) Int. Cl.

H05K 1/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

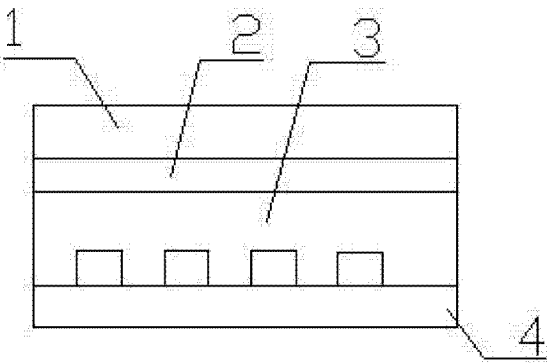
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

空隔型 PCB 板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种 PCB 板，尤其是空隔型 PCB 板。该 PCB 板包括导电层、绝缘层和散热层，散热层上设有绝缘层，绝缘层上设有导电层，散热层是齿状铜层，底板固定在散热层底部，底板为陶瓷板，该 PCB 板能够有效降低其热量，从而防止其因为高温而发生形变，延长了其使用寿命。



1. 空隔型 PCB 板,包括导电层(1)、绝缘层(2)和散热层(3),散热层(3)上设有绝缘层(2),绝缘层(2)上设有导电层(1),其特征是,散热层(3)是齿状铜层。
2. 根据权利要求 1 所述的空隔型 PCB 板,其特征是,底板(4)固定在散热层(3)底部,底板(4)为陶瓷板。

空隔型 PCB 板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种 PCB 板,尤其是空隔型 PCB 板。

背景技术

[0002] PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接提供者。现有技术中 PCB 板被广泛使用,众所周知电子元件在工作过程中是会产生热量的,所以 PCB 板的散热性是一个重要的指标,而现有技术的 PCB 板散热性较差。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有的 PCB 板散热性差的不足,本实用新型提供了空隔型 PCB 板。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:空隔型 PCB 板,包括导电层、绝缘层和散热层,散热层上设有绝缘层,绝缘层上设有导电层,散热层是齿状铜层。

[0005] 根据本实用新型的另一个实施例,进一步包括底板固定在散热层底部,底板为陶瓷板。

[0006] 本实用新型的有益效果是,该 PCB 板能够有效降低其热量,从而防止其因为高温而发生形变,延长了其使用寿命。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0009] 图中 1. 导电层,2. 绝缘层,3. 散热层,4. 底板。

具体实施方式

[0010] 如图 1 是本实用新型的结构示意图,空隔型 PCB 板,包括导电层 1、绝缘层 2 和散热层 3,散热层 3 上设有绝缘层 2,绝缘层 2 上设有导电层 1,散热层 3 是齿状铜层,底板 4 固定在散热层 3 底部,底板 4 为陶瓷板。

[0011] 散热层 3 为齿状铜层,这种形状可以增大散热面积,且能够促进空气在 PCB 板底部流通,而铜质材料更加加大了散热层 3 的散热效率,底层的底板 4 因为是陶瓷板,可以抵御外部化学物品的侵蚀,并且不会受到高温的影响,该 PCB 板能够有效降低其热量,从而防止其因为高温而发生形变,延长了其使用寿命。

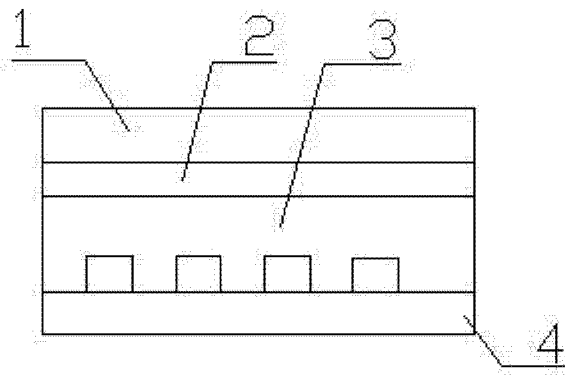


图 1